

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 2005/055317 A1

(51) 国際特許分類7:

H01L 23/10

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/017931

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ): 東 和司 (HIGASHI, Kazushi). 石谷 伸治 (ISHITANI, Shinji).

(22) 国際出願日:

2004年12月2日 (02.12.2004)

(74) 代理人: 河宮 治, 外 (KAWAMIYA, Osamu et al.); 〒5400001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル青山特許事務所 Osaka (JP).

(25) 国際出願の言語:

日本語

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-407232 2003年12月5日 (05.12.2003) JP

特願2003-410046 2003年12月9日 (09.12.2003) JP

特願2003-420643 2003年12月18日 (18.12.2003) JP

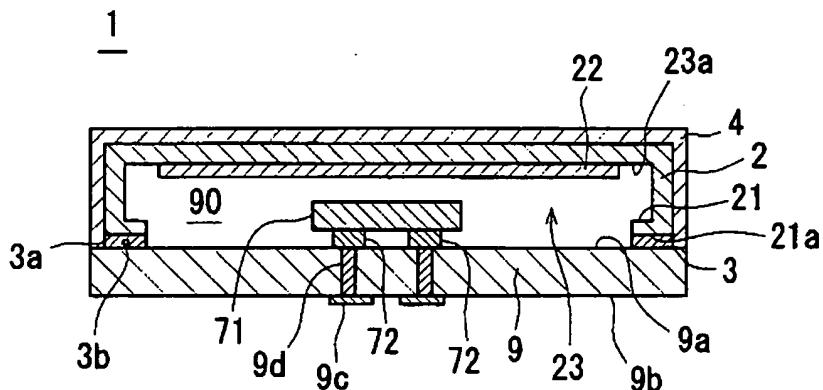
(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,

/競業有)

(54) Title: PACKAGED ELECTRONIC ELEMENT AND METHOD OF PRODUCING ELECTRONIC ELEMENT PACKAGE

(54) 発明の名称: パッケージされた電子素子、及び電子素子パッケージの製造方法



(57) Abstract: A first container member (9, 109, 212) on which an electronic element (71, 171, 261) are mounted and a second container member (2, 102, 202) are joined by an adhesive agent (3) or a metallic layer (103, 251) to form an inner space (90, 190, 211), and the electronic element can be sealed in the inner space at low temperatures. When the adhesive agent is used, an exposed surface of the adhesive agent is covered with a metallic film (4) to improve sealing ability. Further, the electronic element (261, 272) can be mounted also on the second container member, and as a result an electronic element package is highly densely packaged.

(57) 要約: 電子素子 (71, 171, 261) を実装した第1容器部材 (9, 109, 212) と、第2容器部材 (2, 102, 202) とを接着剤 (3, 103) 又は金属層 (103, 251) にて接合することで、内部空間 (90, 190, 211) を形成し、低温にて上記電子素子を上記内部空間内に密閉することができる。接着剤を用いる場合には、接着剤の露出面を金属膜 (4) にて覆い、上記内部空間の密閉性の向上を図る。さらに、上記第2容器部材にも電子素子 (261, 272) を実装することでき、電子素子パッケージにおける高密度化を図ることができる。

WO 2005/055317 A1

ATTACHMENT "A"



BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). 2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

添付公開書類:  
— 国際調査報告書